

<u>Yildiz texnik üniversitesi</u> Fen bilimleri enstitüsü

Schottly Eng. Konek Alirm, Sic. Bağlı Olarak İnc.

Yüksek Lisans Tezi

IŞIK <u>KARABAY</u>

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

	R 210
Kot Alındığı Yer	
Tarih	20.03.1992
Fatura Fiyatı Ayniyat No	
UDC Ek	:530
	YILDIZ WRS/AESI AIND 1937 ISSA

VILDIZ ÜNIVERSITESI D.B. No 46073

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SCHOTTKY ENGELİNDE KAÇAK AKIMLARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ



YÜKSEK LİSANS TEZİ IŞIK KARABAY

ISTANEUL 1988

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

OZET

1 - GIRIŞ

2 - GENEL BILGILER

2.1 - KAVSAK OLUŞUMU, İŞ FONKSİYONU

2.2 - METAL n-TIPI YARIILETKEN KAVŞAKLAR

2.3 - METAL p-TIPI YARIILETKEN KAVŞAKLAR

2.4 - ENGEL YÜKSEKLİĞİ, ARINMA BÖLGESİ

2.5 - KAVŞAKTAKİ AKIMLAR

2.6 - ARINMA BOLGESININ GENIŞLIĞI, KAPASITANSI

3 - DENEL CALIŞMA

3.1 - DENEY SETININ HAZIRLANMASI

3.1.1 - ELEKTRONIK TERMOMETRELI SICAKLIK

KONTROLU CIHAZI

3.1.2 - DC GERILIM KAYNAĞI

3.1.3 - KRİYOSTAT

3.1.4 - DIGER ELEMANLAR VE DENEY SETI

3.2 - KAÇAK AKIMLARIN ÖLÇÜLMESİ

3.2.1 - I-T KARAKTERISTIKLERI

3.2.2 - lnJ - 1/kT EGRILERI VE ENGEL

YUKSEKLİĞİNİN HESAPLANMASI

3.2.3 - SONUÇLAR

- 3.3 SCHOTTKY DIYOTUNUN KAPASITESININ OLÇULMESI
 - 3.3.1 DENEY SETININ HAZIRLANMASI
 - 3.3.2 C-V KARAKTERISTIKLERI VE ARINMA

BOLGESI GENIŞLİĞININ HESAPLANMASI

3.3.3 - SONUÇLAR

4 - SONUÇLARIN DEĞERLENDIRILMESI

5 - EKLER

ĉ.

6 - KAYNAKLAR

ÖZGEÇM1Ş

TEŞEKKÜR

Lisansüstü çalışmamı kendi kurumumda yapmamı sağlayan hocam sayın Prof. Dr. Sevket ERK'e; tez yöneticiliğimi üstlenen ve çalışmamın her aşamasında beni yönlendiren, bilgisinden çok yararlandığım hocam sayın Doç. Dr. Yani SKARLATOS'a; teorik ve pratik çalışmalarımda bana fikir ve eleştirileriyle sürekli destek olan Yrd. Doç. Dr. Süha AKÇİZ'e ; deney setimin hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı Arş. Gör. arkadaşlarım Kemal TOKMANOĞLU, Mustafa ÖMÜR ve Birtan KAVANOZ'a içten teşekkür ederim. Bu çalışmada, piyasada yaygın olarak kullanılan hızlı anahtarlama,mikrodalga vs. uygulamaları gibi hızlı çalışması gereken modern elektronik cihazlarda kullanılan devre elemanlarından olan Schottky diyotları, ters beslenerek sıcaklığa bağlı olarak incelenmiştir.

bölüm, bu diyotlar ve kullanım alanları, 2.
 bölüm ise fiziksel olarak oluşumları hakkında genel
 bilgiler vermektedir. 3. bölümde deneysel çalışma
 anlatılmıştır. I-T, lnJ-1/kT, C-V, 1/C2-V
 karakteristikleri çizilerek, Schottky engel yükseklikleri
 ve arınma bölgesi genişlikleri hesaplanmıştır. Hesaplar
 sonucunda, incelenen diyotların Schottky engel
 yükseklikleri (0,5 - 0,6) eV civarında ve (0 - 6) Volt
 arasında değişen ters gerilim altında arınma bölgesi
 genişliklerinin (4-12) µm arasında değiştiği bulunmuştur.
 4. bölüm sonuçların değerlendirilmesini içermektedir.

61 .

ÖZET

SUMMARY

In the present work, Schottky diodes which are commonly used in modern electronic instruments as applications of fast swiching, microwave etc. are reverse biased and studied under heat treatment.

Chapter 1 gives information about these diodes and their usages , Chapter 2 also gives general information about their physical consistency. In Chapter 3 , experimental procedure is explained ; I-T, lnJ-1/kT, C-V, $1/C^2-V$ characteristics are drawn, and Schottky barrier heights and depletion layer widths are calculated. As a result, Schottky barrier heights are found to be about (0,5-0,6)eV, and depletion layer widths are found to be changed from 4µm to 12µm while the examined diodes are reverse biased from 0,5V to 6V.

Chapter 4 includes the discussions about the results.

1. GIRIS

iletkenlerin akım taşıyıcıları, band yapısına bağlı olmaksızın, o iletken içinde hapsedilmiş durumdadır. Cismin yüzeyi, akım taşıyıcılarının dışarı çıkmaları için bir engel teşkil eder. Cismin içinde de akım taşıyıcıları için engeller olabilir. Elektronik yarıiletken elemanların pek çoğu, yarıiletkenin içinde veya yüzeyinde oluşan engellerden yararlanılarak hazırlanırlar. Engel tabakalarının varlığından yararlanılarak hazırlanan cihazlar; diyot, transistör, fototransistör, diak, triak, güneş pilleri gibi elemanlar aveya bunların biraraya getirilmelerinden oluşan entegre devreler vs. dir.

Metal-yarıiletken temas bölgesindeki potansiyel engeline Schottky engeli denir. Bugün artık çok kısa anahtarlama süreleri olan Schottky diyotları geliştirilmiştir. Bu diyotların anahtarlama süreleri 10⁻¹¹saniye mertebesindedir. Bu da, Schottky diyotlarının radyoelektronik darbe devrelerinde, bilgisayarlarda ve yüksek operasyonel hız gerektiren otomasyon devrelerinde kullanılmalarını sağlar.

1

2. GENEL BILGILER

METAL-YARIILETKEN KAVŞAKLAR

2.1 KAVSAK OLUSUMU - IS FONKSIYONU

tki malzeme birbirine değme durmuna getirildiğinde, denge durumuna ulaşana kadar yeniden bir yük dağılımı olur. Bu denge durumuna ulaşınca, iki malzemenin Fermi düzeyleri eşitlenir. Metal - yarıiletken kavşakların davranışı, yarıiletkenin p veya n tipi olmasına ve bu durumlarda metalin iş fonksiyonunun yarıiletkenin iş fonksiyonuna nazaran aldığı değere göre değişir.Fermi seviyesindeki bir elektronu vakum seviyesine çıkarmak için gerekli olan minimum enerjiye metalin iş fonksiyonu

$$\Phi = W - E_{F}$$
 (2.1.1)

İki malzemenin birbirine değmesinden oluşan yeni yük dağılımı, kavşakta bir dipol tabaka oluşturur. Metalmetal kontakta bu dipol tabaka kavşağın her iki yanında yüzey yüklerine neden olur. Böyle bir kontağa, elektronlar serbestçe bir metalden diğerine geçebildiği için, omik kontak denir. Bir metalle bir yarıiletken biraraya getirildiğinde, kontak omik veya doğrultucu (redresör) karakterinde olabilir. Doğrultucu kontakta elektronlar bir yönde, diğer yönden çok daha kolay giderler ki bu da iki malzemenin elektronik enerji düzeyleriyle yakından ilgilidir. 2.2 METAL n- TIPI YARIILETKEN KAVŞAKLAR

Sekil (2.2.a) ve sekil (2.2.c) sırasıyla $\Phi_M \rightarrow \Phi_S$ ve Φ_M < Φ₌ durumlarında kontak oluşmadan önceki ve şekil (2.2.b) ve sekil (2.2.d) ise kontak oluştuktan sonraki metalin ve yarıiletkenin enerji seviyesi diyagramlarını göstermektedir.

Şekil (2.2.b) deki kontak doğrultucu gibi davranır, çünki $\Phi_{M}-\Phi_{B}$ engeli, yarıiletkenin iletkenlik bandı içindedir. Şekil (2.2.d) iletkenlik bandında görünür bir engel olmadığı için omik kontak gibi davranır.

Vakum düzeyi ile iletkenlik bandı alt kenarı arasındaki W enerji farkına elektron afinitesi denir ve ile gösterilir. Burada referans düzeyi olarak iletkenlik bandının alt kenarı alındı.



Sekil (2.2.a) KONTAKTAN ÖNCE Sekil (2.2.b) SONRA KONTAKTAN



Sekil(2.2.c) $\varphi_{m} < \varphi_{s}$ KONTAKTAN ÖNCE

Sekil (2.2.d) $q_m < KONTAKTAN SONRA$

2.3 METAL p - TIPI YARIILETKEN KAVŞAKLAR

Sekil (2.3.a) ve şekil (2.3.c) sırasıyla $\Phi_{M} \langle \Phi_{B}$ ve $\Phi_{M} \rangle \Phi_{B}$ durumlarında kontak oluşmadan önceki ve şekil (2.3.b) ile şekil (2.3.d) kontak oluştuktan sonraki metal ile p-tipi yarıiletkenin enerji seviyesi diyagramlarını göstermektedir. Şekil (2.3.b) deki kontak doğrultucudur, çünki $\Phi_{B}-\Phi_{M}$ engeli hollerin akışına göre vardır. Şekil (2.3.d) de akımın akışı karşısında bir engel yoktur ve onun için omiktir.

Sonuç olarak, metal n-tipi yarıiletkende $\Phi_M > \Phi_B$ durumunda ve metal p-tipi yarıiletkende $\Phi_M < \Phi_B$ durumunda kontaklar doğrultucu diğer durumlarda omiktir.





2.4 ENGEL YÜKSEKLIĞI, ARINMA BÖLGESI

Burada, iş fonksiyonu, yarıiletkenin iş fonksiyonundan büyük olan $(\Phi_M > \Phi_S)$ bir metal ile değme halinde bir ntipi yarıiletkeni inceleyeceğiz

Kontak oluşmadan önce, şekil (2.2.a) da görüldüğü qibi yarıiletkenin Fermi düzeyi, metalin Fermi düzeyinin $(\Phi_{M} - \Phi_{B})$ kadar üstündedir. Kontak oluştuktan sonra, yarıiletkenden elektronların bir kısmı, daha alçak enerji bulmak için metale geçerler. Bu, metali daha negatif, yarıiletkeni ise daha pozitif yapar ve Coulomb kuvvetleri dolayısıyla bu yükler her iki ortamın temas bölgesinde yoğunlaşır. Metalin iletkenlik bandında çok sayıda enerji seviyesi olduğundan, fazla elektronlar ince yarıiletkende tabakada birikebilirler fakat bir elektronların ayrılmasıyla geride kalan donor atomları, bulundukları şebeke noktalarını terkedemezler. Bundan dolayı, yarıiletkenin yüzey bölgelerinde, pozitif bir uzay yükü oluşur. Bu bölge, metaldekine göre daha derindir ve hareketli yüklerden arınmış durumdadır. O yüzden bu bölgeye arınma bölgesi denir.

Band eğilmesi, Fermi ve vakum düzeylerinin uyuşmasının bir sonucudur ve yük dengesizliği bundan oluşur. Yük dengesizliğine ve potansiyel enerjide değişmeye neden olan elektronlar yarıiletkenden ayrılınca, bir potansiyel engeli oluşur. (Yani yarıiletkenin elektrostatik potansiyeli-elektron enerjilerini düşürmek için-metal'e göre yükselir). Bu potansiyel engeli metalin iş fonksiyonu ile yarıiletkenin iş fonksiyonu arasındaki farka eşittir ve akımın metal-yarıiletken kavşağından geçişini kontrol ederek kavşağa doğrultucu özelliği kazandırır. Yarıiletken tarafında potansiyel engelinin yüksekliği $\Phi_{M}-\Phi_{S}$, metal tarafında ise Fermi seviyeleri aynı yükseklikte olduğu için $(\Phi_{M}-\Phi_{S})+(\Phi_{S}-S)=\Phi_{M}-\chi_{S}$ kadardır. Dışardan gerilim uygulandığında metal tarafında engel değişmeyeceği için $\Phi_{M}-\chi_{S}$ metal-yarıiletken çiftinin engeli olaraktanımlanır.

$$\Phi_{Bn} = \Phi_M - \chi_S \tag{2.4.1}$$

Yarıiletken tarafında, volt olarak ifade edilmiş engel yüksekiliği,

$$qV_{b1} = \Phi_M - \Phi_S \qquad (2.4.2)$$

dir.

Burada V_{bi} difüzyon potansiyelidir. Yarıiletkenin içinde ve metalin üstündeki yük yoğunlukları, hemen hemen tamamı yarıiletkenin arınma bölgesine yerleşmiş elektrik alanı oluşturur.

2.5 KAVŞAKTAKİ AKIMLAR

Termik uyarılmalardan dolayı, metalin bazı elektronları engeli aşıp yarıiletken içine girmek için ve yarıiletkenin bazı elektronları da engeli aşıp metale girmek için yeterli enerjiye sahip olabilirler.

Bu kavşakta, akımın, çoğunluk taşıyıcılarından ileri

geldiğini düşündüğümüz için, hol akımlarını ihmal ediyoruz.

Kavşaktaki net elektron akım yoğunluğu, J_{MB} ve J_{BM} bileşenleri arasındaki fark kadardır. Denge durumunda, yani dışardan hiçbir gerilim uygulanmadığı durumda, net akım yoğunluğu;

$$J = J_{MS} + J_{SM} = 0$$
 (2.5.1)

olur. Burada,

J_{MS}: Metalden yarıiletkene doğru olan akım yoğunluğu, J_{SM}: Yarıiletkenden metale doğru olan akım yoğunluğudur.

$$J_{MS} = Jo ise, J_{SM} = - Jo olur.$$
 (2.5.2)

Dışardan kavşağa bir potansiyel uygulandığında, yarıiletkenden metale doğru olan akım yoğunluğu, termoiyonik emisyon teorisinden;

$$J_{\text{SM}} = A^{*}T^{2} \exp \frac{qVa}{kT} \exp \frac{qVa}{kT}$$
(2.5.3)

dir. Burada A* efektif Richardson sabitidir. Serbest elektron için Richardson sabiti 120 A/cm²K² dir. n tipi Si için minimum A* değeri <100> yönünde oluşur,ve

 $\begin{bmatrix} A^* \\ \hline A \end{bmatrix} = 2.1 \text{ dir.}$

Burada,

 $A^* = \frac{4\pi q m^* k^2}{h^3}$

Metalden yarıiletkene geçen elektronlar için engel, dışardan uygulanan voltaja bağlı olmadığı için, bu akım yoğunluğu V=0 daki J=M akım yoğunluğuna, yani satürasyon akım yoğunluğuna eşittir.

$$J_{MS} = -A^{*}T^{2} \exp \frac{-q\Phi_{BR}}{kT} = Jo$$
 (2.5.4)

tür.

dır. O halde, kavşaktaki toplam akım yoğunluğu (2.5.3) ve (2.5.4) ü toplayarak

$$J = J_{MB} + J_{BM} = A * T^2 exp - \frac{-q\Phi_{BR}}{kT} \left[exp - \frac{qV}{nkT} - 1 \right] (2.5.5)$$

olur. Burada, n diyotun idealite faktörüdür ve değeri 1 ile 2 arasında değişmektedir. İdeal diyot için n=1 dir. (2.5.5) denklemi,

$$J = Jo \left[exp \frac{-qV}{nkT} - 1 \right]$$
(2.5.6)

seklinde de yazılabilir.

ileri besleme durmunda (yarıiletken - yapılırsa)
(2.5.5) denkleminden kavşaktaki akım yoğunluğu,



şeklinde olur. Şekil (2.5.a) ileri besleme halinde kavşağın durumunu göstemektedir.



Şekil (2.5.a) V>0

İLERİ BESLEME

Ters besleme durumunda ise, kavşaktaki toplam akım yoğunlğu;

$$J = -Jo = -A^{*}T^{2} \exp \frac{-q\Phi_{BR}}{kT}$$
 (2.5.8)

şeklinde olur. Şekil (2.5.b) ters besleme halinde kavşağın durumunu göstermektedir.

Diyətun geri besleme akım yoğunluğu bilinirse, potansiyel engeli hesaplanabilir. (2.5.8) den,

$$\Phi_{Bn} = \frac{kT}{q} \ln \frac{A*T^2}{J}$$
(2.5.9)

dir.



Sekil (2.5.b) V<0

TERS BESLEME

2.6 ARINMA BÖLGESININ GENIŞLIĞI, KAPASITANSI

Metal, yarıiletkenle temas durumuna getirildiğinde, yarıiletkenin iletkenlik ve valans bandları, metaldeki Fermi seviyesiyle tam bir enerji bağımlılığına gelir. Poisson denklemi kavşağa uygulanırsa;

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = - \frac{f(x)}{\epsilon_s}$$
(2.6.1)

olur. Elektronun potansiyel enerjisi $\Theta(x) = -qV(x)$ olduğundan;

$$\frac{d^2 \Theta(x)}{dx^2} = \frac{q f(x)}{\epsilon s}$$
(2.6.2)

olur. Uzay yük yoğunluğu $\hat{y}(x)$ i hesaplarken, bütün donor atomlarının iyonize olduğunu ve bunların elektronlarının metale geçtiğini düşünüyoruz. O halde, $\hat{y}(x) = qN_{D}$ dir.Bunu Poisson denkleminde yerleştirirsek;

$$\frac{d^2 \Theta(x)}{dx^2} = \frac{q^2 N_D}{\varepsilon_B}$$
(2.6.3)

şeklinde olur. Yarıiletkenin içinde x ≥ W uzaklığında kontak alanı olmadığını düşünerek, şu sınır şartlarını yazabiliriz. Şekil (2.6.a)

$$\Theta(W) = 0 , \qquad \qquad \left[\frac{d\Theta(x)}{dx} \right]_{x=W} = 0 \qquad (2.6.4)$$

(2.6.3) denkleminin genel çözümü,

$$\Theta(x) = \frac{q^2 N_D}{2\epsilon_B} (W-x)^2 \qquad (2.6.5)$$

şeklinde olur. x = 0 için $\Theta(0) = V_{bi}$ olduğundan,arınma bölgesinin genişliği;

$$V = \frac{2\varepsilon s (V_{b1} - V - kT/q)}{qN_{D}}$$
(2.6.6)

olarak bulunur. Burada kT/q düzeltme faktörü olarak gelmiştir.



Sekil (2.6.a)

Yarıiletkenin birim yüzeydeki uzay yükü;

$$Q_{=0} = qN_{D}W = \left[2q \in sN_{D}(V_{D\pm} - V - kT/q) \right] \qquad (2.6.7)$$

ve buradan kavşağın birim yüzeyinin kapasitansı;

$$C = \frac{Q_{--}}{V} = \frac{q \in sN_{D}}{2 (V_{D+} - V - kT/q)}$$
(2.6.8)

olarak bulunur. (2.6.8) denklemi;

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2 (V_{bi} - V - kT/q)}{q \in sN_{D}}$$
(2.6.9)

seklinde yazılabilir.

3.1 DENEY BET

Buradan,

$$\frac{d(1/C^2)}{dV} = \frac{2}{qE_3N_p}$$
(2.6.10)

olur. $1/C^2$ ile geri besleme voltajı V arasında çizilen grafik bir doğru ise, n bölgesinin katkı konsantrasyonu olan N_D, arınma bölgesi boyunca sabit demektir ve doğrunun eğiminden hesaplanabilir. Bu doğrunun voltaj ekseni ile kesim noktası ise, V_{D1} değerini verir. Ters besleme durumunda kavşağın potansiyel eşiği;

$$\Phi_{Bn} = V_{Di} + EC - E_{F}$$
 (2.6.11)

kadardır. Burada,

$$Ec - E_F = kT ln - \frac{Nc}{N_D}$$

(2.6.12)

ve Nc iletkenlik bandındaki efektif durum yoğunluğudur.

$$N_{\rm C} = 2 \left[\frac{2\pi m_{\rm m} * kT}{h^2} \right]^{3/2}$$
 (2.6.13)

3. DENEL ÇALISMA

3.1 DENEY SETININ HAZIRLANMASI:

3.1.1 ELEKTRONIK TERMOMETRELI SICAKLIK KONTROLU CIHAZININ GERÇEKLEŞTIRILMESI:

Deneyde kullanılan elektronik termometreli sıcaklık kontrolu cihazı, elektronik termometre ile sıcaklık kontrolu devresinin bir uygunlaştırma devresiyle birleştirilmesinden meydana gelmiştir.

Cihazın elektronik termometre kısmında sıcaklık okumak için kromel-alumel termoçifti kullanılmıştır. Termoçift, sıcaklık farkına duyarlı olduğundan, sıcaklık ölçümü yapabilmek için, referans noktasının sıcaklığının bilinmesi gerekir. Çıkış voltajı yaklaşık olarak , sıcaklığı ölçülen bölge ile, referans bölgesinin sıcaklıkları arasındaki farkla orantılıdır. Bu orantı sabitine Seebeck katsayısı denir. Deneyde kullanılan termociftin Seebeck katsayısı 40µV/°C dir. Referans noktasını buzun içinde tutmak yerine, termoçiftin çıkışına kompansasyon voltajını eklemek esasına dayalı olarak bu termometre hazırlanmıştır. Böylelikle, gerçek sıcaklıktan bağımsız olarak, referans bölgesi LM329B entegresiyle 0°C de tutulmuştur. Bu kompansasyon voltajı termoçiftin aynı orantı sabitiyle sıcaklığa orantılı yapılarak çevredeki sıcaklık değişimlerini çıkış voltajını etkilememesi sağlanmıştır.



Sekil (3.3.1.a) SICAKLIK KONTROLU CHAZININ DEVRE SEMASI

Bu devrede kulanılan LM335 sıcaklık sensörünün voltaj sıcaklık karakteristiği oldukça lineerdir ve bu sensör değişik akım seviyelerinde çalışan iki transistörün baseemitter voltajlarının farkına duyarlı olarak çalışır.

Termoçift ile sıcaklık ölçümü yapılırken asıl hata termoçiftin toleransından kaynaklanır. Tolerans, termoçiftin voltaj-sıcaklık karakteristiğinin, ideal termoçiftinkinden ne kadar farklı olduğunu belirtir. Kullandığımız termoçiftin tolerası ±% 3/4 tür. Cihazın 10mV/°C çıkışlı elektronik termometre kısmı 0°C-1300°C aralığında sıcaklık okuyabilmektedir.

Cihazın diğer bölümü SG3524N entegresi kullanılarak hazırlanmış sıcalık kontrolü kısmıdır. SG3524N regülatörlü güç kaynaklarının anahtarlamasında yaygın olarak kullanılan bir kontrol elemanıdır. Güç uygulandığı zaman, SG3524N nin pozitif çıkışı, negatif çıkışından daha büyük potansiyel değerinde olur ve bu da ısıtıcıyı çalıştırarak çıkışın yükselmesini sağlar. İstenilen sıcaklığa yaklaşık olarak erişildiğinde ısıtıcının güç devri %90 (tam çalışmadan) kontrol edilmesi istenilen değer sabit kalana kadar azalır. SG3524 ün 9 no'lu ayağındaki 330k-4,7µF birleşimi otomatik kazancı 1Hz de S5dB de tutar. 6 ve 7 no'lu ayaklardaki 0,02µF-2,7k birleşimi ise darbe frekansını 15kHz ler civarında tutar.

LM308A'nın çıkış voltajı, SG3524N'yi uygun olarak çalıştırmaya kafi gelmediği için, hazırlanan uygunlaştırma devresiyle cihazın bu iki bölümü

17

birleştirildi. Şekil(3.1.1.a) Baskılı devre şeması EKLER bölümündedir.

Bu cihazın ±15 Voltluk regüleli besleme devresi Şekil(3.1.1.b) de görüldüğü gibi hazırlandı.



Sekil (3.3.1.b) BESLEME DEVRESI

3.1.2 DC GERILIM KAYNAGI:

Diyotlara ters besleme uygulamak için devre şeması Şekil(3.1.2.a) da görülen 0-85 Volt arasında değişken yaklaşık 2 Volt ince ayarlı DC gerilim kaynağı hazırlandı. Diyotlara, ters beslendiklerinde, geçirdikleri akım çok küçük olduğundan böyle, basit bir gerilim bölücüden oluşan gerilim kaynağı yeterli olmuştur.



Sekil (3.1.2.a) D.C. GERİLİM KAYNAĞI

3.1.3 KRİYOSTAT:

Çalışılan diyotların kaçak akımlarının sıcaklığa bağlı olarak değişimlerinin 0°C-120°C aralığında duyarlı olarak incelenebilmesi için, diyotlar kriyostat içine yerleştirilmiştir. Sekil (3.1.3) de görülen kriyostat, biri etrafı kalayla kaplanmış cam kap ve diğeri onun içine oturtulmuş altı bakır, üstü nikel içi boş hazne olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Bakır kısmın ucunda, yine bakırdan numune yeri ve kenarında ise termoçiftin yerleşmesi için bir delik bulunmaktadır. Numune yerinin üzerine, gücü 20 Watt'lık bir ısıtıcı olacak şekilde direnç teli sarılmıştır. Kriyostattan çıkan termoçift birbirinden izole edilerek, sıcaklık kontrolu devresine gitmektedir.



Şekil (3.1.3) KRİYOSTAT

Kriyostatın iç haznesine dışarıdan tuz-buz karışımı konulup vakuma alınarak, 0°C ye kadar rahatlıkla inilebilmiş, böylelikle, 0°C-120°C aralığında numune istenilen sıcaklıkta tutulabilmiştir.

3.1.4 DIGER ELEMANLAR:

Deney setinde kullandığımız diğer elemanlar, laboratuvarımızda bulunan;

> - 10⁻¹-10⁻¹¹ Amper aralığında okuma yapılabilen Keithley marka 616 dijital elektrometre

- Vakum aleti

— Rezistansı beslemek için gerekli olan akım kontrollu D.C.gerilim kaynağıdır.

Deneyde kullandığımız Schottky diyotları, alelade seçilmiş ve piyasada yaygın olarak kullanılan ITT BA157, BA159 ve MR856-8424 no'lu diyotlardır.

Yukarıda belirtilen elemanlarla şeması Şekil (3.1.4) de gösterilen deney seti hazırlanmıştır.



Şekil (3.1.4.) DENEY SETI

3.2 KAÇAK AKIMLARIN ÖLÇÜLMESI

3.2.1. I-T KARAKTERISTIKLERI:

Şekil (3.1.4) deki deney seti hazırlandıktan sonra, diyotlara sabit bir ters gerilim uygulayarak, ve 0°C-120°C arasında sıcaklık değiştirilerek, kaçak akımlar okundu ve I-T karakteristikleri çizildi.(Grafik 1)



3.2.2. lnJ-1/kT KARAKTERISTIKLERI:

Diyotlar dikkatle kesilerek Silisyum kristalinin boyutları mikroskopla ölçüldü ve yüzeyleri,

aı	=	1.414	10-2	cm ²	(BA157)
az	=	1.208	10-2	cm ²	(BA159)
aa	=	4.337	10-2	cm ²	(MR-856-8424)

olarak hesaplandı. Akım yoğunlukları bulunarak, (2.5.8) bağıntısından lnJ-1/kT karakteristikleri çizildi. (Grafik 2)



3.2.3 SONUÇLAR

Çizilen doğruların lineer regresyon hesapları yapılarak, doğruların eğimlerinden Schottky engel yükseklikleri hesaplandı.

Eğim	B1	=	-0,55	eV
	Ba	=	-0,49	eV
	Вз	=	-0,49	e۷

Korelasyon	sabiti	r.	=	0,999
		r a	=	0,999
		r 3	=	0,999

Schottky engel yüksekliği	PBn1	=	0,55	eV	
	ØBn2	=	p,49	eV	
	Ø Bn3	=	0,49	eV	

Burada 1,2,3 sırasıyla BA157, BA159 ve MR856-8424 diyotlarını göstermektedir. 3.3 SCHOTTKY DIYOTUNUN KAPASITESININ ÖLCÜLMESI:

3.3.1 DENEY SETININ HAZIRLANMASI:

Schottky diyotlarının kapasitelerini ölçmek için laboratuvarımızda bulunan AIM marka LCR Databridge 401 kullanılmıştır. İki tarafı bakır plaket kesilerek, şekil (3.3.1.a) daki gibi dışarıdan gerilim uygulanarak diyotların kapasiteleri ölçülebilir vaziyete getirildi. Daha sonra, Şekil (3.3.1.b) deki deney seti hazırlanarak, oda sıcaklığında (27°C) ve (80°C) de değerler alındı.



Sekil (3.3.1.a) KAPASITANSMETRE



Sekil (3.3.1.a) DENEY SETI

3.3.2 C-V KARAKTERISTIKLERI VE ARINMA BOLGESI GENIŞLIĞININ TAYINI:

Diyotlar, 0-6 Volt arasında ters beslenerek, kapasiteleri kapasitansmetrede okundu ve C-V karakteristikleri çizildi. (GRAFIK 3) (2.6.6) bağıntısına göre arınma bölgesi genişlikleri hesaplandı. Alınan ölçümler ve hesap sonuçları TABLO 1,TABLO 2 ve TABLO 3 dedir. Daha sonra diyotlar (10-20-30) Volt altında ters beslenerek, 27°C ve 80°C de kapasiteleri okundu, arınma bölgesi genişlikleri hesaplandı.Alınan ölçümler ve hesap sonuçları TABLO 4, TABLO 5, ve TABLO 6 dadır.



T	A	B	L	0	1	

(BA157)

V(Volt)	C(pF)	1/C ² (pF) ⁻²	C/a1(pF/m-2)	W(µm)
0,5	33,2	9,10.10-4	23,48.10*	4,49
1	26,4	1,43.10-3	18,67.10°	5,64
2	23,7	1,78.10-3	16,76.10*	6,28
3	18,3	3,00.10-3	12,94.10*	8,14
4	16,4	3,70.10-3	11,60.10*	9,08
5	14,3	4,90.10-3	10,11.10°	10,42
6	12,6	6,30.10-3	8,91.10*	11,80
		Stand and and	a section in	Sec. 40

Т	A	B	L	0	2
-		_	_	_	_

(BA159)

V(Volt)	C(pF)	1/C ² (pF)-2	C/a1(pF/m-3)	W(µm)
0,5	31,8	9,88.10-4	26,32.10*	4,00
1	25,7	1,51.10-3	21,27.10°	4,90
2	21,2	2,24.10-3	17,55.10°	6,00
3	17,2	3,40.10-3	14,24.10°	7,40
4	15,2	4,52.10-3	12,58.10*	8,38
5	13,6	5,51.10-3	11,27.10°	9,35
6	11,9	7,00.10-3	9,86.10°	10,69

TO	BI	0	7	

(MR856-8424)

V(Volt)	C(pF)	1/C ² (pF) ⁻²	C/a1(pF/m-3)	W(µm)
0,5	65,2	2,35.10-4	14,35.10°	7,34
1	41,4	5,82.10-4	9,55.10*	11,03
2	31,6	9,98.10-4	7,30.10*	14,43
3	26,9	13,81.10-4	5,99.10°	17,60
4	23,8	17,65.10-4	5,48.10°	19,22
5	21,2	22,28.10-4	4,88.10*	21,59
6	19,4	26,54.10-4	4,47.10*	23,57
				1

T		P	1	n	4
	-	~	-	-	

BA157	T=300°K		T=353°K	
V(Volt)	C(pF)	W(µm)	C(pF)	W(µm)
910110	10,0	14,9	8,9	16,7
20	7,2	20,7	5,8	25,7
gec 30 be	5,9	25,3	5,0	29,8
		A. C. Star		

TABLO 5

BA159	T=300°K		T=353°K	
V(Volt)	C(pF)	W(µm)	C(pF)	W(µm)
10	9,5	13,4	8,9	14,3
20	6,8	18,7	5,9	21,6
30	5,5	23,1	4,9	25,9

TABLO 6

MR856-8424	T=300°K		T=353 °K	
V(Volt)	C(pF)	W(µm)	C(pF)	W(µm)
10	15,2	30,1	14,2	32,2
20	10,8	42,4	9,6	47,8
30	8,8	51,8	7,8	58,6

3.3.3 1/C², V KARAKTERISTIKLERI VE ENGEL YÜKSEKLIĞININ HESAPLANMASI:

Olçülen kapasitans değerlerine göre 1/C² değerleri hesaplanıp, 1/C²-V karakteristikleri çizildi.(Grafik 4) Doğruların eğiminden n-bölgesinin katkı konsantrasyonu N_D ve doğruların voltaj eksenini kestiği noktadan ise V_{D1} değerleri hesaplanarak Schottky engel yükseklikleri bulundu.



Çizilen doğruların eğimlerinden, n- bölgesinin katkı konsantrasyonları ve buradan iletkenlik bandı ile Fermi seviyesi arasındaki enerji farkları, (2.6.12) bağıntısına göre bulundu ve (2.6.11) bağıntısından Schottky engel yükseklikleri hesaplandı.

Eğim

B1=	1,89	109	F-2	A-1
Ba=	1,57	109	F-2	A-1
Ba=	7,99	109	F-2	V-1

Korelasyon	sabiti	r1=	0,989
		r_=	0,996
		ra=	0.998

Vbi1= 0,24 eV Doğrunun voltaj eksenini kestiği nokta Vbis= 0,26 eV Vbi3= 0,23 eV

iletkenlik bandı ile $(EC-E_{F})_{1}=0,33 eV$ Fermi seviyesi arasındaki (Ec-E_F)₂= 0,33 eV enerji farkı (Ec-Er) = 0,37 eV

Schottky engel $\Phi_{Bn1}=0,57 eV$ yüksekliği

Фвл2= 0,59 eV Фвлз= 0,6 eV

Burada 1,2,3 sırasıyla BA157, BA159 ve MR856-8424 diyotlarını göstermektedir.

4. SONUÇLARIN DEGERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada, BA157, BA159, MR856-8424 diyotlarının kaçak akımları, sıcaklığa bağlı olarak incelenmiştir. 0°C-120°C arasında değiştirilen sıcaklığa bağlı olarak, kaçak akımların üstel olarak arttığı gözlenmiştir.Bu diyotlar, 40 Voltluk bir gerilimle ters beslendiğinde, 0°C'de akım, (4-10) nA mertebesinde iken, oda sıcaklığı bölgesinde (30-100) nA mertebesine, sıcaklık 120°C'ye yükseldiğinde ise, (4-10) yA mertebesine ulaşmıştır. Akımdaki bu artış, sıcaklık arttıkça elektronların enerjilerinin, termoiyonik emisyon teorisine uyarak artmasından dolayıdır. Bir başka deyişle, engelden cm² başına geçen elektron sayısı, sıcaklık arttıkça fazlalaşmaktadır.

Bazı çalışmalarda, "*** sabit gerilim altında, sıcaklık 450°C civarına kadar yükseldiğinde, Is saturasyon akımının, dolayısıyla Schottky engel yüksekliğinin biraz azaldığı ancak bu sıcaklığın üzerine çıkıldığında, engel yüksekliğinde artma görüldüğü belirtilmiştir. Ancak bu çalışmada, incelenen sıcaklık aralığında, Schottky engel yüksekliğinin sabit kaldığı görülmüştür.

Aynı zamanda, C-V karakteristikleri de ölçülmüştür. 1/C²-V çizimlerinden, taşıyıcı konsantrasyonları ve eğrinin ekseni kestiği noktadan, difüzyon potansiyelleri hesaplanmıştır. Bu hesaplar sonucunda, BA157, BA159, MR856-8424 için iletkenliğin ve özdirencin sırasıyla, $\sigma_1 = 15 \text{m}\Omega \text{cm}$, $f_1 = 66(\Omega \text{cm})^{-1}$; $\sigma_2 = 18 \text{m}\Omega \text{cm}$ $f_2 = 55(\Omega \text{cm})^{-1}$; $\sigma_3 = 3.55 \text{m}\Omega \text{cm}$, $f_3 = 280(\Omega \text{cm})^{-1}$ olduğu bulunmuştur. Bu değerler taşıyıcı konsantrasyonundan hesaplanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde, ters gerilim (0.5-6) Volt arasında değiştirilerek, arınma bölgesi genişlikleri de hesaplanmıştır.

Kapasite değerleri, 300°K ve 353°K'de ters gerilim değiştirilerek tekrar ölçülmüş ve bu değerlerin sıcaklık arttıkça azaldığı görülmüştür. Bu da taşıyıcı konsantrasyonunun artmasından dolayıdır. Taşıyıcı konsantrasyonu artınca, arınma bölgesinin genişliği artmakta, dolayısıyla kapasite azalmaktadır.



Elektronik Termometreli Sıcaklık Kontrolu Cihazının Baskılı Devre Şeması

```
10 REM ' I - T KARAKTERISTIGI
20 SCREEN 3
30 PRINT CHRs(12)
40 Ds="d350":Rs="r630":Ys="d5":Ls="L5"
50 PSET(10,0):DRAW Ds:DRAW Rs
60 FOR T=1 TO 13 :G=G+50 : IF G>600 THEN G=0
70 PSET (10+G,350):DRAW Y$ :PSET(10,350-G):DRAW L$:NEXT
80 LOCATE 20,70:PRINT " Derece C":LOCATE 2,3:PRINT "I
90 FOR I=1 TO 77
100 READ X,Y
110 PSET (10+5*X,350-100*Y)
120 NEXT I
130 As=INPUTs(1): IF As=" " THEN STOP
140 DATA 4,.01147,5,.012,8,.01549,10,.01726,13,.01993,
    15,.0219,20,.0292,23,.0345,25,.0392,30,.0525,32,.0598
150 DATA
        35,.0723,40,.098,45,.134,50,.183,55,.237,
    60,.314,65,.414,70,.547,75,.704
160 DATA 80,.818,85,1.103,90,1.271,95,1.565,100,1.921
170 DATA 105,2.35,110,2.9,115,3.52,120,4.29
180 DATA 0,.0103,5,.0215,10,.0346,15,.0491,20,.0745,
    25,.1034,30,.1475
190 DATA 35..24.40..288.45..36.50..48.55..62.60..78.
    65,.977,70,1.21,75,1.538
200 DATA 80,1.92,85,2.44,90,3.07,95,3.81,100,4.86,
    105,6.81,110,7.58,115,8.73
210 DATA 0,.00406,5,.00626,10,.0091,15,.01315,
    20,.01774,25,.024,30,.0388
220 DATA 35,.055,45,.0976,50,.1297,55,.1717,
    60,.0229,65,.376,70,.43
230 DATA 75, .563, 80, .74, 85, .96, 90, 1.242, 95, 1.597, 100,
    2.37,105,2.94,110,3.98
```

240 DATA 115,4.53,120,5.13

```
10 REM ' lnJ - 1/kT KARAKTERISTIGI
20 SCREEN 3
30 PRINT CHR$(12)
40 Us="u350":Rs="r500":Ys="d5":Ls="L5"
50 PSET(10,355):DRAW US:DRAW Rs
60 FOR T=1 TO 5 :G=G+50 : IF G>150 THEN G=0
70 PSET (110+2*G,0):DRAW Y$ :PSET(10,405-2*G):DRAW L$:NEX
80 LOCATE 3,60:PRINT "1/kT (eV)^-1":LOCATE 23,5:PRINT "L
90 FOR I=1 TO 74
100 READ X.Y
110 PSET (-490+20*X.-395-50*Y)
120 NEXT I
130 As=INPUTs(1): IF As=" " THEN STOP
140 DATA 42.438,-14.906,41.827,-14.473,41.088,-14.099,
    40.375,-13.731,39.686,-13.431,39.02,-13.129,38.376,
    -12.649.37.753. -12.45.37.15. -11.96.36.566. -11.726
150 DATA 36,-11.442,35.551,-11.161,34.919,-10.873,
    34.402,-10.377,33.901,-10.243,33.414,-9.974,32.94,
    -9.7,32.48,-9.44,32.033,-9.183,31.589,-8.931,31.174,-8
160 DATA 30.762,-8.321,30.36,-8.18,29.97,-8.05,29.59,-8.02
170 DATA 42.438,-14.08,41.827,-13.98,41.088,-13.616,40.375
    -13.378,39.686,-13.09,39.02,-12.796,38.376,-12.504,37.
    -12.184,37.15,-11.88,36.566,-11.567
180 DATA 36,-11.255,35.451,-10.996,34.919,-10.715,34.402,
    -10.439,33.901,-10.16,33.414,-9.908,32.94,-9.758,32.48
    -9.459,32.033,-9.317,31.598,-9.109,31.174,-8.904
190 DATA 30.762,-8.702,30.36,-8.492,29.97,-8.298,29.59,-8.
200 DATA 41.827,-14.517,41.088,-14.042,40.375,-13.692,39.6
    -13.275,39.02,-12.947,38.376,-12.592,37.753,-12.105,37
    -11.922,36.566,-11.699,36,-11.412
210 DATA 35.451,-11.156,34.919,-10.926,34.402,-10.701,33.9
    -10.487,33.414,-10.247,32.94,-10.025,32.48,-9.786,32.0
    -9.556,31.598,-9.34,31.174,-9.097
220 DATA 30.762,-8.869,30.36,-8.652,29.97,-8.511,29.59,-8.
```

```
10 REM ' C - V
                 KARAKTERISTIGI
. 20 SCREEN 3
 30 PRINT CHR$(12)
 40 Ds="d350":Rs="r630":Ys="d5":Ls="L5"
 50 PSET(10,0):DRAW D$:DRAW R$
 60 FOR T=1 TO 13 :G=G+50 : IF G>600 THEN G=0
 70 PSET (10+G,350):DRAW Y$ :PSET(10,350-G):DRAW L$:NEXT
 80 LOCATE 21,68:PRINT " V ( Volt )":LOCATE 1,1:PRINT "C (
90 FOR I=1 TO 21
100 READ X.Y
 110 PSET (10+100*X,349-5*Y)
 120 NEXT I
130 As=INPUTs(1): IF As=" " THEN STOP
140 DATA 0.5,33.2,1,26.4,2,23.7,3,18.3,4,16.4,5,14.3,
     6,12.6,0.5,31.8,1,25.7,2,21.2,3,17.2,4,15.2,5,13.61,
```

6,11.91,0.5,65.23,1,41.45,2,31.65,3,26.9,4,23.8,

```
5,21.18,6,1
```

```
10 REM ' 1/C^2 - V KARAKTERISTIGI
20 SCREEN 3
30 PRINT CHR$(12)
 40 Ds="d350":Rs="r350":Ys="d5":Ls="L5"
50 PSET(10,0):DRAW D$:DRAW R$
60 FOR T=1 TO 13 :G=G+50 : IF G>300 THEN G=0
70 PSET (10+G,350):DRAW Y$ :PSET(10,350-G):DRAW L$:NEXT
80 LOCATE 21,38:PRINT " V ( Volt )"
90 LOCATE 1,2:PRINT "1/C^2 ( F)^-2"
100 FOR I=1 TO 21
110 READ X,Y
120 PSET (10+50*X,349-50*Y)
130 NEXT I
140 A$=INPUT$(1):IF A$=" " THEN STOP
150 DATA 0.5,0.91,1,1.43,2,1.78,3,3,4,3.7,5,4.9,6,6.3,0.5,
0.988,1,1.51,2,2.24,3,3.4,4,4.52,5,5.51,6,7.06,0.5,0.2
```

```
1,0.582,2,0.998,3,1.381,4,1.765,5,2.228,6,2.654
```

```
5 REM ' KORELASYON HESABI
10 DEFDBL A-P,R-Z
20 INPUT "ilk deney no";Z
30 INPUT " son DENEY NO"; V
40 A=.01414:AA=252:KB=.000086
50 DIM Y(85), T(85), I(85), J(85), X(85), C(35), P(35), S(35)
60 FOR Q=1 TO 29
70 READ Y(Q), I(Q):NEXT:CLS
80 FOR Q=Z TO V
90 T(Q)=Y(Q)+273 :W=W+1
100 C(Q) = AA * T(Q) * T(Q)
110 X(Q) = (1/(KB*T(Q)))
120 J(Q) = I(Q) * .000001 # / A : S(Q) = LOG(J(Q))
140 NEXT
150 L=L+X(Q)*S(Q)
160 X=0: S=0: XS=0: X2=0
170 FOR Q=Z TO V
180
    X=X+X(Q)
190 S = S + S(Q)
200 XS = XS + X(Q) * S(Q)
210 X2=X2+X(Q)*X(Q)
220 S2 = S2 + S(Q) * S(Q)
230 NEXT
240 N=V-Z+1
250 UU=N*XS-X*S:U3=N*XU-X*U
260 WW=N*X2-X*X
270 TT=N*S2-S*S:T3=N*U2-U*U
280 E=UU/WW:E3=U3/WW
290 B=(S-E*X)/N:B3=(U-E3*X)/N
300 CC=UU/SQR(WW*TT):C3=U3/SQR(WW*T3)
310 PRINT "ES=";E, "BS=";B, "CS=";CC
320 DATA 4,.01147,5,.012,8,.01549,10,.01726,13,.01993,
    15,.0219,20,.0292,23,.0345,25,.0392,30,.0525,32,.0598
330 DATA 35,.0723,40,.098,45,.134,50,.183,55,.237,
    60,.314,65,.414,70,.547,75,.704
340 DATA 80,.818,85,1.103,90,1.271,95,1.565,100,1.921
350 DATA 105,2.35,110,2.9,115,3.52,120,4.29
```

ES=-.48526141165

BS= 6.228962342

CS=-

6. KAYNAKLAR

1 - A.G. MILNES & D.C. FEUCHT

Heterojunctions and Metal - Semiconductor Junctions, 1972, Academic Press.

2 - S.M. SZE

Physics of Semiconductor Devices, 1981, John Wiley & Sons.

3 - A. Van Der ZIEL Solid State Physical Electronics 1964, Prentice - Hall.

4 - Richard DALVEN

Introduction to Applied Solid State Physics 1980, Plenum Press.

5 - G.I. EPIFANOV

Solid State Physics, 1979, Mir Publishers.

6 - Harold J. HOVEL

Semiconductors and Semimetals, 1975, Academic Press.

7 - Ralph J. SMITH

Electronics : Circuits and Devices, 1967,

8 - Sait AKPINAR

Yarıiletkenler Fiziği, 1979, İ.Ü.Fen Fakültesi.

9 - Sait AKPINAR

Katıhal Fiziğinden Seçme Konular 5,

- 10 A.Y.C. YU & C.A. MEAD Characteristics of Al-Si Schottky Barrier Diode Solid State Electronics. Per. Press 1970 Vol.13 p.p 97-104
- 11 E.C. WURST, Jr., & E.H. BORNEMAN
 Rectification Properties of Metal-Silicon
 Contacts

Journal of Applied Physics, Vol.28, No 2, Feb. 1957

12 - A.M. COWLEY & E.H. BORNEMAN Surface States and Barrier Height of Metal-Semiconductor Systems Journal of Applied Physics, Vol.36,No 10,Oct.1965

13 - F.A. PADOVANI & R. STRATTON

Field & Thermionic-Emission in Schottky Barriers Solid State Electronics 1973. Vol. Per. Press 1966, Vol. 16, p.p 695-707

14 - A. Van CALSTER

Behavior of Al- Si Schottky barrier diodes under heat treatment.

Solid State Electronics 1973. Vol.16 p.p 119-121

15 - A.Y.C.YU,

"The Metal-Semiconductor Contact:An Old Device with a New Future"

IEEE Spectrum, 7, 83-89 (March 1970)

16 - Müzeyyen SARITAŞ

Schottky diyodunda potansiyel engelinin ölçülmesi. Y.Ü. Mühendislik Fakültesi Sempozyumu, 1988.

17 - National Semiconductor Corporation Linear Databook.



ÖZGEÇMIŞ

1957 yılında Kayseri'de doğdu. Orta öğrenimini T.E.D. Kayseri Koleji ve Kadıköy Maarif Kolejinde tamamladı.1980 yılında İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdi. 1986 yılından beri Y.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.



